

基板仕様

Board Specification

		日本JAPAN	韓国KOREA	台湾TAIWAN
片面版	one side version	○	○	○
両面版	Double side version	○	○	○
多層版 Multi-layer version	リジッド Rigid	4~8層	○	4~34層
	FPC	×	○	○
	メタルベース Matal base	×	○	○
材質	紙フェノール paper phenol	×		×
	FR-4	○	○	○
	CEM-3	○	○	○
	低誘電率材料 low dielectric constant material	×	○	○
	高Tg材 High Tg material	×	○	○
	パナソニック電工材 (R1705)	○		○
	パナソニック電工材 (R-1787 ECOOL)	×		○
	アルミ Aluminum	×	○ (1層断面だけ可能)	○
材の厚み Thickness of material	mm	0.5/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 (0.5mm 2.0mm価格UP)	0.4 ~ 3.0mm (PCB 厚さ)	0.5/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 (0.5mm 2.0mm価格UP)
銅箔の厚み Copper Foil Thickness	μm	18/35/70	12 18 35 70	18/35/70
最小パターン幅/間隔 Minimum pattern width / Land diameter		0.1/0.1 (18μ材)	0.1mm< 可能	0.05/0.05 (18μ材)
インピーダンス制御 Impedance control		±10% 測定可能	Impedance 可能	±10% 測定可能
最小ビア径/ランド径 Minimum pier Dimeter/Land diameter		φ0.25/0.55 φ0.3/06	0.2 / 0.4	φ0.25/0.55 φ0.3/06
レジスト色 resist color		白 緑 青 黒 (艶有)	白 緑 赤 青 光沢のある黒 艶消し黒 (PSR 色)	白 緑 青 黒 (艶有)
シルク色silk color		白 黄色 黒	白 黒	白 黄色 黒
表面処理 surface treatment		プリフラックス 鉛フリーレベラー 共晶レベラー 無電解金	水溶性フラックス、無鉛はんだレベラー、電解金メッキ、無電解金メッキ	プリフラックス 鉛フリーレベラー 共晶レベラー 無電解金
面取り加工 Charmfering		端子メッキ部のみ 角度指定なし		端子メッキ部のみ 角度指定なし
外形寸法 External dimensions		最大480×480	50mm×50mm ~ 500mm×500mm	最大480×615
特殊加工 special processing		対応無し	樹脂穴埋め、パッド・オン・ビア	対応無し
面付け imposition		Vカット ルーター ミシン目	Vカット、ルーター切り出し	Vカット ルーター ミシン目
検査方法 Inspection method		フライングチェッカー AOI 目視	flying probe teste	フライングチェッカー AOI 目視
その他 others		ULマーク挿入可	ULマーク挿入可	ULマーク挿入可